

Pressemitteilung

30/09/2010

AT&S auf der Weltleitmesse electronica in München

Innovative Embedded Components Packaging Technologie ist eines der Highlights auf dem neu gestalteten Messestand

Innovativ, jung und dynamisch – so präsentiert AT&S ihr umfangreiches Produktportfolio sowie ihre technologischen Innovationen auf ihrem neuen Messestand auf der electronica 2010. Die drei Kompetenzinseln widmen sich jeweils einem der drei Geschäftsfelder des Unternehmens – Mobile Devices, Automotive und Industrial. Die electronica gilt als Weltleitmesse für Komponenten, Systeme und Anwendungen und findet heuer von 9. bis 12. November in München statt. Der AT&S Stand befindet sich in Halle B1, Stand 125.

Immer kleinere Geräte mit gleichzeitig immer komplexeren Anforderungen sind die Herausforderung der Zukunft. „Innovationskraft und technologische Weiterentwicklung sind Kernelemente unserer Unternehmensstrategie“, erklärt CEO Andreas Gerstenmayer, AT&S. „Mit der Embedded Component Packaging Technologie investiert AT&S in die Zukunft der Leiterplatte – die ECP® ist eine höchst effiziente Technologie zur Integration von aktiven und passiven elektronischen Komponenten in eine Leiterplatte.“ ECP® ermöglicht eine breite Anwendungspalette, von Single Chip Modulen und Leiterplatten mit eingebetteten passiven Komponenten bis hin zu komplexen System-in-Package Modulen und System-in-Board Applikationen.

Mit Leiterplattenwerken in Österreich, darunter das größte europäische HDI-Leiterplattenwerk in Leoben-Hinterberg, sowie in Indien, China und Korea ist AT&S als globaler Partner in der Lage, rasch und flexibel auf Kundenanforderungen zu reagieren und Kunden aktiv bei der Weiterentwicklung ihrer Produkte zu unterstützen. Im Fokus des weitaus größten Leiterplattenherstellers Europas steht das Ziel, das Endprodukt so qualitativ hochwertig und kostengünstig wie möglich zu gestalten.

Zusatzdienstleistungen wie Designlösungen und langjährige Supply-Chain-Kompetenz sowie Vorteile des One-Stop-Shopping runden das Angebot ab und machen AT&S zu einem langfristigen und finanzkräftigen Partner in den Geschäftsfeldern Automotive, Industrial und Mobile Devices.

Schwerpunkttechnologien der AT&S auf der electronica 2010:

- ECP® - Embedded Component Packaging Technologie
- 2.5D™ Technologie
- Starrflexible Leiterplattenprofil
- HDI Microvia Leiterplatten
- Feinstleitetertechnologie
- HSMtec

AT&S Produktportfolio:

- Einseitige Leiterplatten
- IMS (Insulated Metallic Substrate)
- Doppelseitige Leiterplatten mit durchkontaktierten Bohrungen
- Multilayer-Leiterplatten bis zu 22 Lagen
- HDI-Microvia-Leiterplatten
- Semiflexible Leiterplatten
- Flexible Leiterplatten
- Starrflexible Leiterplatten

© Registered Trademark AT 255868

Über AT&S

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der leistungsstärksten Leiterplattenproduzenten. Insbesondere im höchsten Technologiesegment, den HDI-Microvia-Leiterplatten, welche vor allem in Mobile Devices zum Einsatz kommen, ist AT&S weltweit bestens positioniert. Erfolgreich ist der Konzern auch im Segment der Automotive-Leiterplatten sowie im Industrie- und Medizintechnikbereich tätig. Als internationales Wachstumsunternehmen verfügt AT&S über eine globale Präsenz mit drei Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring, Klagenfurt) sowie Werken in Indien (Nanjangud), China (Shanghai) und Korea (Ansan nahe Seoul). Weitere Infos auch unter www.ats.net.

Presserückfragen:

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
Martin Theyer | Director Strategy Development & Communications | +43 3842 200-5909 | m.theyer@ats.net